



新闻稿

LiquidJet Diamond 冷板可将 AI 工厂盈利能力提升高达 35%

AI 行业独角兽 Frore Systems 最新冷板创新 LiquidJet Diamond，改善极限热点散热，大幅提升 AI 数据中心的效率与盈利能力

加利福尼亚州圣何塞——2026 年 10 月 7 日——Frore Systems 今日发布 LiquidJet Diamond，一款面向 AI 工厂、采用集成金刚石均热板的新型液冷板。AI Token 需求加速增长，加之能源日益紧缺，正推动超大规模运营商寻找提升 AI 工厂效率的新途径。与传统铲齿冷板相比，LiquidJet Diamond 冷板可将 AI Tokens/Watt 和营收提升 35%，新增营收直接转化为利润。

LiquidJet Diamond 基于 Frore Systems 此前发布的 LiquidJet 冷板打造。LiquidJet 冷板采用独特的 3D 超短回路多级设计，可针对每颗 GPU 的功率分布图（含极限热点）进行精准定制。随着 GPU 为满足 AI 需求而日趋复杂、功耗不断攀升，这种精准度至关重要。LiquidJet 可将 GPU 裸片温度降低 12°C，直接带来 Tokens/Watt 效率提升 25%。LiquidJet Diamond 在冷板底部增加了一层集成金刚石晶圆的均热板，精准覆盖热点位置，使热点裸片温度再降 10°C，将 Tokens/Watt 提升至 35%。

Frore Systems 创始人兼首席执行官 Seshu Madhavapeddy 表示："AI 工厂正面临严峻的性能瓶颈。GPU 功率密度不断攀升，形成极限热点，若不能有效散热，将阻碍 GPU 充分释放性能。LiquidJet Diamond 在创新的 3D 超短回路多级设计之外，还集成了金刚石均热板，可冷却高达 770 W/cm² 的极限热点，释放高性能 AI GPU 的全部潜力，带来更高的 AI Tokens/Watt。"他接着表示："每颗 GPU 效率更高，意味着每个 AI Token 的生产成本更低；在可用功率预算内，借助相同的 AI 工厂基础设施，可以生成更多 AI Token。这既提升了 AI 工厂的盈利能力，也节约了本地资源。"

AI 工厂可用电力有限，扩容成本高昂。电力并网、变压器容量和物理供电基础设施，都是 AI 工厂总功耗的瓶颈，也日益引发当地社区的担忧。面对电力约束，AI 工厂运营商深知电力是战略资产，每一瓦电力都必须用于以最高效率生成 Token。

Seshu 表示："如果每座 AI 工厂通过部署 LiquidJet Diamond，以相同资源多产出 35% 的 AI Token，超大规模运营商就能以更少的 AI 工厂更快实现增长目标。每座新建 AI 工厂的建造成本高达数百亿美元，运营成本更高；因此，用现有资源实现更高的 AI Tokens/Watt，可以显著提升利润、节约能源，并为所有利益相关方带来显著价值。"

LiquidJet® Diamond：为 AI 高速增长打造的创新 3D 超短回路多级冷板

LiquidJet Diamond 与铲齿冷板相比的性能表现：

- 热点散热：最大功率密度提升超 150%
- 传热效率提升 75%
- GPU 温度降低 16–22°C
- AI Tokens/Watt 提升 30–35%
- 无缝直接替换升级

在尺寸与产量两方面均可扩展，满足 AI 数据中心需求。

LiquidJet Diamond 直击行业最紧迫的散热挑战——不仅凭借卓越性能与热点管理，更凭借可扩展至超大规模量级的能力。传统铲齿工艺无法实现当今 AI GPU 所要求的严苛散热性能。ECAM（电化学增材制造，亦称 3D 金属打印）等新工艺虽具设计灵活性，却无法满足超大规模运营商在质量、可靠性、产量与交付周期方面的要求。LiquidJet 将半导体制造的精度与大批量制造能力相结合——同时满足领先 AI 数据中心冷板部署的性能与规模要求。

更高的散热性能与大批量制造，并非 LiquidJet 解决的唯二挑战。GPU 裸片尺寸正在急剧增大：从 1,488 mm² 的 NVIDIA Blackwell Ultra，到 46,225 mm² 的 Cerebras 晶圆级引擎，占位面积相差约 30 倍。凭借 LiquidJet，Frore Systems 开创了唯一一种冷板制造工艺，既能满足这些尺寸更大的 AI GPU 在功率与性能方面的要求，也能满足其尺寸要求。

亲眼见证 LiquidJet

在 2026 年 OCP 全球峰会上，Frore Systems 将展示其最新创新成果，现场演示 LiquidJet 与 LiquidJet Diamond 冷板针对 2300W NVIDIA Rubin 及 770 W/cm² 极限热点密度的散热表现，以及面向 ½U 计算托盘的集成冷板系统 LiquidJet Nexus。

体验为 AI 打造的液冷散热。热管理技术栈创新始于 Frore Systems——2026 年 10 月 12–16 日，加利福尼亚州圣何塞 McEnery 会议中心，展厅 F4 展位。

关于 Frore Systems

Frore Systems 是先进散热技术的开拓者，致力于释放数据中心与边缘设备的性能潜力。公司旗舰解决方案包括 AirJet®——全球首款固态主动散热芯片，应用于消费、工业和物联网市场，为超紧凑、静音、轻薄、防尘防水的边缘设备带来更高性能；LiquidJet®——面向数据中心的 3D 超短回路多级液冷冷板，以及集成金刚石均热板的 LiquidJet® Diamond，带来更高的 GPU 性能、AI Token 吞吐量，改善 PUE 并降低 TCO；以及 LiquidJet® Nexus——轻量化集成冷板系统，整合多块 LiquidJet，省去所有软管、接头和分液歧管，支持 ½U 计算托盘。Frore Systems 的专利散热技术已集成于全球主要 OEM 和系统厂商的产品中。公司总部位于硅谷，在台湾设有制造业务，Frore Systems 正在重新定义 AI 时代的热架构。更多信息，请访问：www.froresystems.com。

媒体联系：

Sue Ryan —— Frore Systems 市场副总裁

sue@froresystems.com

手机：+1 314 914 5008